



MSL FPGA INC 晶片參數

■ 芯片概述

MAX6639AEE+ 是来自 MSL FPGA INC 美时龙的一款双通道温度监控与 PWM 风扇控制芯片，采用QSOP-16 封装，适用于服务器、工控设备等场景的散热管理，支持I2C/SMBus 接口和自动风扇调速。以下是其关键信息：

■ 核心参数

- 工作电压：3V 至 3.6V (典型值)。
- 温度监测：2 路远程温度传感器输入，精度 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (-40°C 至 $+125^{\circ}\text{C}$ 范围)。
- 风扇控制：支持 1 路 PWM 输出，频率可调 (1.4 kHz 或 25 kHz)。

■ 功能特性

- 警报功能：通过 SMBALERT 引脚触发超温或风扇故障中断。
- 低功耗：工作电流仅 500 μA ，支持关断模式。

■ 应用场景

- 服务器散热：监控 CPU/GPU 温度，动态调节风扇转速 (如 AI 服务器散热模块)。
- 工业控制：用于 PLC 或通信设备的温度保护电路。